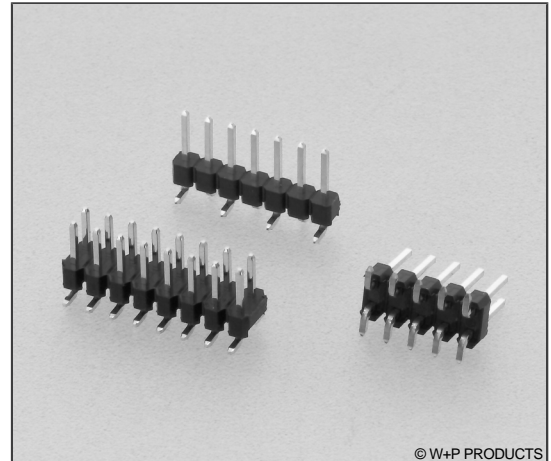


9532 / 9132

SMT-Stiftheilen RM 2,54mm, stehend – geprägte Kontakte SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical – Stamped & Formed Contacts

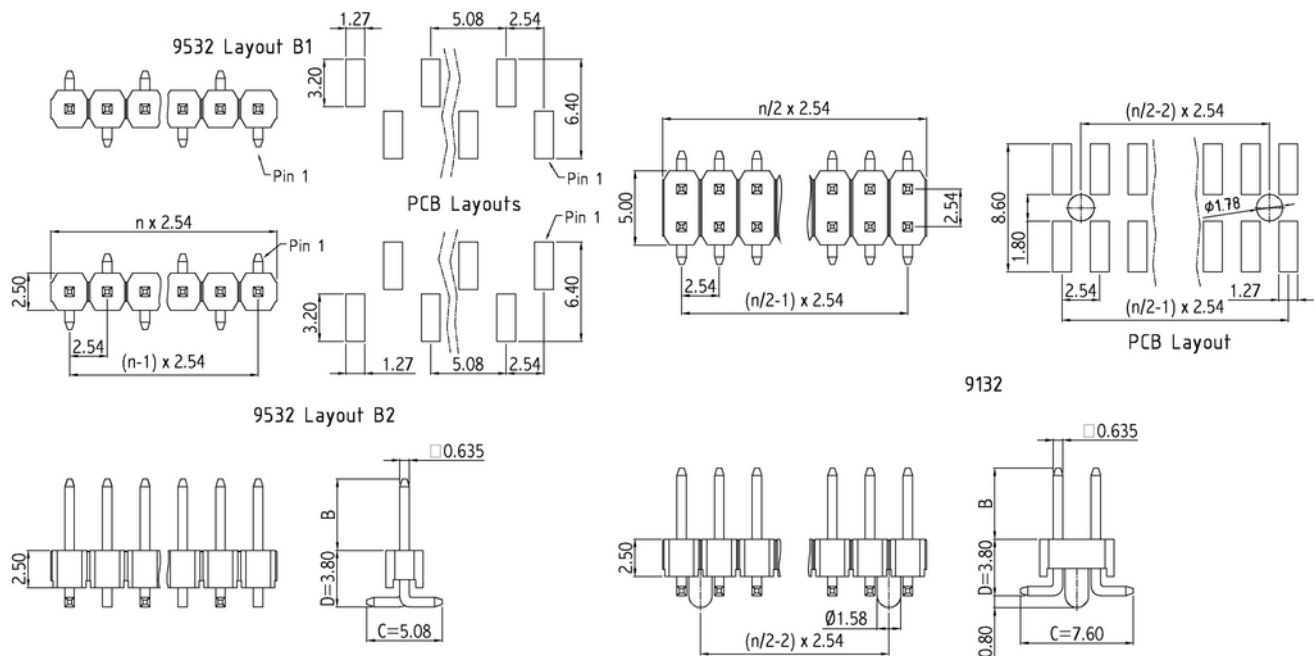
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
3490 3491 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Loc. Pegs*	Packaging*
9132	13	020	60	0	00	PPTR
Gestanzte/geprägte Kontakte <i>Stamped/formed contacts</i>	12 B=3,50mm 13 B=4,80mm 14 B=6,10mm 15 B=6,90mm 16 B=9,90mm 17 B=5,84mm 18 B=8,13mm 99 Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	003-040 Einreihig <i>Single row</i> 004-080 Zweireihig <i>Double row</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Sel. Au/Sn</i>	0 (Für Serie 9132) <i>(For series 9132)</i> 1 Layout B1 (9532) 2 Layout B2 (9532)	00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen (9132) <i>With loc. pegs (9132)</i>	ST PPST PPTR (Option)

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options on request.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

